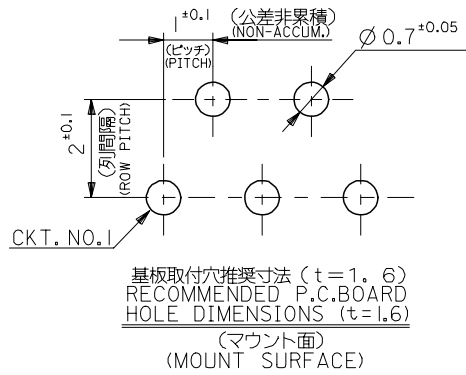


(仕上り厚さ) : $0.3^{+0.05}_{-0.05}$
 (THICKNESS) : $0.3^{+0.05}_{-0.05}$
 適合F.P.C推奨寸法
 APPLICABLE F.P.C
 RECOMMENDED DIM.



注記:
 NOTES:
 △ CKT. NO. 1を基準に偶数番目のソルダーテール。
 EVEN NUMBER SOLDER TAIL.
 △ CKT. NO. 1を基準に奇数番目のソルダーテール。
 ODD NUMBER SOLDER TAIL.
 3. 材料:
 MATERIAL:
 ターミナル : リン青銅
 TERMINAL : PHOSPHOR
 めっき 接点部 : 金めっき 0.1 MICROMETER 以上。
 PLATING CONTACT AREA : Au PLATING 0.1 MICROMETER MIN.
 半田付け部 : 鉛めっき 1.0 MICROMETER 以上。
 TAIL AREA : Sn PLATING 1.0 MICROMETER MIN.
 下地めっき : ニッケルめっき 1.0 MICROMETER 以上。
 UNDER PLATING : Ni PLATING 1.0 MICROMETER MIN.
 ハウジング : 66ナイロン, UL94V-0
 HOUSING : 66NYLON, UL94V-0
 アクチュエーター : ポリエステル, UL94V-0
 ACTUATOR : POLYESTER, UL94V-0
 4. 本製品は52030シリーズの金めっき品である。
 THIS PRODUCT IS Au PLATING OF 52030 SERIES.

25.3	21.2	52030-2075	20
22.3	18.2	-1775	17
21.3	17.2	-1675	16
19.3	15.2	-1475	14
17.3	13.2	-1275	12
15.3	11.2	-1075	10
11.3	7.2	52030-0675	6
B	A	MATERIAL NO.	極数 CKT.
		MODEL NO.	52030-**75

FPCについて:
 打抜き方向は導体側から補強板側を推奨致します。
 補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
 接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

ABOUT FPC:
 RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FORM CONDUCTOR
 SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
 RECOMMENDED MATERIAL :
 STIFFENER FILM : POLYIMIDE
 BONDING AGENT : THEROSETTING BONDING AGENT

RELEASED EC NO: J2006-1888 DR: WAKUMEDA CHK: KIKUYODO APPR: NUKITA 2005/12/06 2005/12/07 2005/12/09	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M.UMEDA	DATE 2005/12/05	TITLE 1.0 FPC CONN ZIF ST			
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K.TOYODA	DATE 2005/12/05	-LEAD FREE-			
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE 2005/12/05	MOLEX INCORPORATED			
0	ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-52030-019	SHEET NO. 1 OF 1		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						